



2024年5月10日

各 位

会 社 名 株式会社レスター
(コード：3156 東証プライム市場)
代表者名 代表取締役副社長 朝香 友治
問い合わせ先 執行役員 石田 有都己
(電話：03-3458-4618)

SBI ホールディングス株式会社との資本業務提携に関するお知らせ

当社は、東京証券取引所プライム市場に上場する SBI ホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：北尾 吉孝、以下「SBI」）と本日付で資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」）を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 資本業務提携の目的

当社は、「世界・社会貢献・共創と革新」の経営ビジョンのもと、半導体・電子部品の販売・ソリューション提供をはじめ、放送・公共向けの映像・音響・通信機器の取り扱い、NFC（近距離無線通信）技術を融合した決済・出入管理システムの開発・製造・販売、太陽光・風力発電所をはじめとする再生可能エネルギーの企画・オペレーション、植物工場運営など多岐にわたる事業活動を行い、あらゆるニーズに対応できる「エレクトロニクスの情報プラットフォーマー」を目指しております。また、多様な事業展開を通じて保有する情報を価値に変え、グループシナジーの創出とともに様々なパートナー企業との共創により社会課題である地方創生にも取り組み、新たなサービスの創造・提供に努めております。

一方、SBI グループは、1999 年の創業以来、「顧客中心主義」の考え方のもと、インターネットをメインチャネルとした金融サービス事業を中心とした金融生態系を構築し、SBI グループ全体の顧客基盤は 2024 年 3 月末時点で 5,000 万を超えています。また SBI グループは「金融を核に金融を超える」という事業構築の基本観のもと、金融サービス事業とシナジーを発揮する事業領域にも積極的に進出しており、SBI グループ各社が培ってきた金融・投資機能だけでなく、事業法人とのネットワーク構築にも寄与する半導体事業への参入を発表し、日本の半導体産業の再興に繋げるべく、JSMC ホールディングス株式会社による半導体ファウンドリの建設に向けた準備を進めております。

当社と SBI グループは、これまでも CVC ファンドの設立やベンチャーファンドへの出資、半

導体を中心としたデバイス事業での連携などで信頼関係を構築してまいりました。この度、デバイス事業における協業、戦略的な投資における連携、地方創生に関する分野での協業関係を一層強化することを目的に、本資本業務提携契約の締結に至りました。

2. 業務提携の内容

- (1) SBI グループの JSMC ホールディングス株式会社による半導体事業において、当社による営業代行、技術サポート、調達及び物流代行、製品の品質管理支援等を通じた協業による事業機会の創出、収益機会の拡大
- (2) SBI グループの SBI インベストメント株式会社と当社が共同組成した CVC ファンドや当社が出資する SBI インベストメント運営のベンチャーファンドなど、投資の領域において、相互間の連携や補完による成長の加速
- (3) SBI グループが注力する地方創生の分野において、当社が取り組む地方自治体向けスマートソリューションの事業等に関する協業の推進

3. 資本提携の内容

SBI は、当社の既存株主から普通株式 1,000,000 株（2023 年 12 月 31 日時点の発行済株式総数に対する割合 3.3%）を取得する予定です。

4. 資本業務提携先の会社概要

名称	SBI ホールディングス株式会社
所在地	東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号
代表者の役職・氏名	代表取締役会長兼社長 北尾 吉孝
事業内容	株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等
資本金	143,811 百万円（2023 年 12 月 31 日現在）
設立年月日	1999 年 7 月 8 日

5. 業績への影響

本件による当社の 2025 年 3 月期連結業績への影響は軽微であると見込んでおります。

以上